

Tentti 05.03.2001

1. Selitä lyhyesti mutta tyhjentävästi seuraavat termit: (12p)
 - CAE
 - SI-analyysi
 - HPGL
 - Logic Decal
 - APLAC
 - Ominaisimpedanssi (Z_0)
 - DUT
 - MOM
 - SMT
 - EDIF
 - VSWR
 - Signal Pin (PADS)
2. Piirilevy-suunnitteluprosessin päävaiheet ja siitä saatavat dokumentit. Mitä vaihtoehtoja piirilevy-suunnitteluohjelmistot antavat suunnitteluun? (12p)
3. Mihin elektroniikkasuunnittelussa käytetään seuraavia ohjelmistoja ja miten ne tukevat elektroniikkasuunnittelun dokumentointia? (6p)
 - OrCAD Capture & PSPICE
 - PADS
 - ADS
4. Olet töissä tuotekehitysfirmassa. Saat tehtäväksi simuloida alla olevan kytkennän toimivuutta. Mitä muita dokumentteja ko. kytkentäkaavion lisäksi tarvitset voidaksesi suorittaa tehtävästä? Mitä vaiheita simulointiprosessi pääpiirteissään käsittää simuloidessasi esim. piirin taajuusvastetta? (5p)
5. Vastasiko kurssi odotuksiasi? Jos vastasi, niin oliko kurssista mielestäsi muutakin hyötyä kuin ansaitut opintoviikot. Jos ei vastannut, niin miksi? (1p)

